

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种电镀Cu叠层膜及其制备方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

94

下载

0

收藏

0

**作者** 于志明, 崔荣洪 and 牛云松**发表日期** 2011-07-20**专利国别** 中国**专利类型** 发明专利**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明涉及叠层膜的制备技术,具体为一种不仅具有优良耐磨、耐腐蚀性能,而且与基体材料结合强度高、可抑制裂纹的产生与扩展的电镀Cu叠层膜及其制备方法,解决为提高Cu镀层与基体材料的结合力而采用氰化物镀铜时产生的剧毒污染问题。本发明采用电镀工艺并间歇导入超声波的技术,制备了一种铜叠层镀膜,其制备方法: 经过除油、净化处理的金属基底材料,进行电镀Cu叠层镀膜,当铜叠层镀膜达到所需要的厚度时,取出清洗干净并进行干燥后,即可得到制好的电镀Cu叠层镀膜。获得的金属铜膜呈层状结构,铜膜的单层厚度在0.08~2.5微米范围内,总厚度在3.2微米~50微米范围内根据实际需求可以进行调整。本发明简单易行、成本较低。

**公开日期** 2011-07-20**语种** 中文**专利申请号** CN102127784A**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/66704>] **专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所**推荐引用方式** 于志明, 崔荣洪 and 牛云松. 一种电镀Cu叠层膜及其制备方法. 2011-07-20.**GB/T 7714**[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号